

**特点:**

- 1dB 带宽:  $\geq 20\text{MHz}$
- 40dB 带宽:  $\leq 27.5\text{MHz}$
- 带外抑制:  $\geq 40\text{dB}$
- 封装尺寸:  $13.3 \times 6.5 \times 2$  (max) mm
- 工作温度:  $-55 \sim +85^\circ\text{C}$
- 产品执行标准为 GJB3515-1999

**图片:**

**性能参数: ( $T_A=25^\circ\text{C}$ ,  $50\Omega$ 系统)**

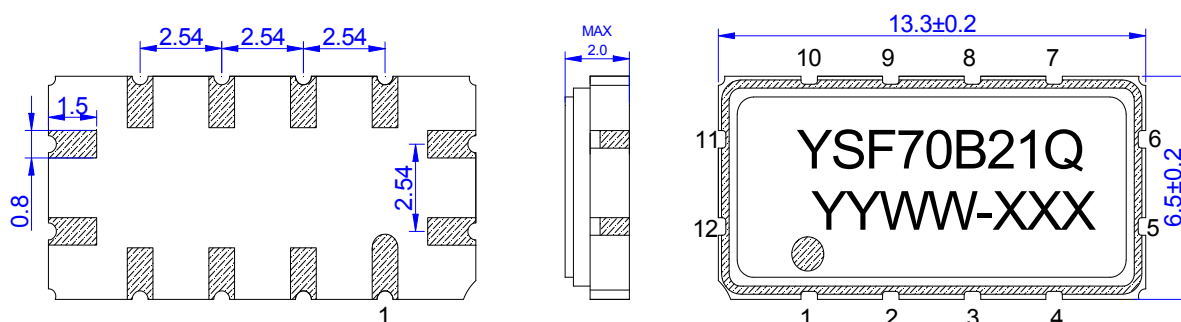
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	$f_0$	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=70\text{MHz}$ , SPAN=60MHz		70		MHz	
1dB 带宽	$BW_{-1dB}$		20	21.5		MHz	
40dB 带宽	$BW_{-40dB}$			26.5	27.5	MHz	
插入损耗	IL			11	12	dB	
带内波动	Rip			0.5	1	dB	
群时延波动	Delay	$f_{TEST} = 70\text{MHz} \pm 10\text{MHz}$ 范围内		30	100	ns	
带外抑制		$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=70\text{MHz}$ , SPAN=100MHz	40			dB	
质量	m				2	g	

**极限参数表:**

参数名称	极限值	单位
贮存温度	$-55 \sim 100$	$^\circ\text{C}$
输入射频功率	10	dBm

**封装外形及引脚标识图:**

单位: mm

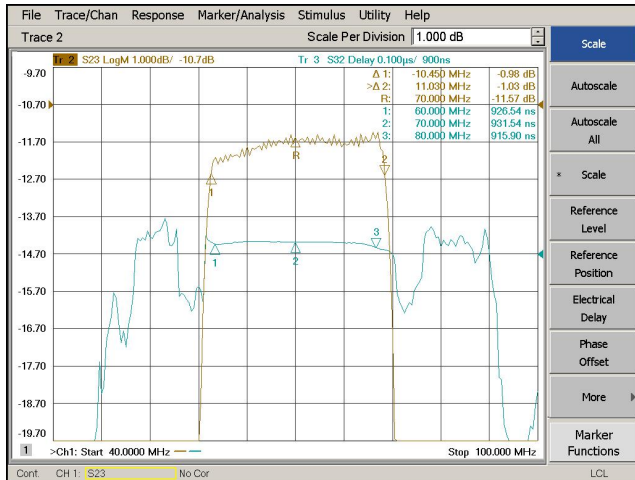


注: 1、未标注公差按 GB/T1804—2000 规定, 公差等级 f;

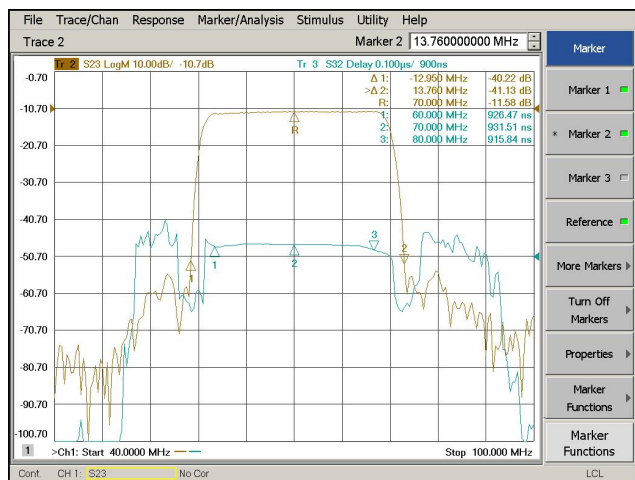
 2、产品本体采用氧化铝陶瓷金属封装, 引脚及底部焊盘表面镀镍金 (Ni 1.2~8.9 $\mu\text{m}$ , Au 1.2~5.7 $\mu\text{m}$ );

3、产品标识采用激光刻字, 完成后盖板和底座进行平行缝焊处理。

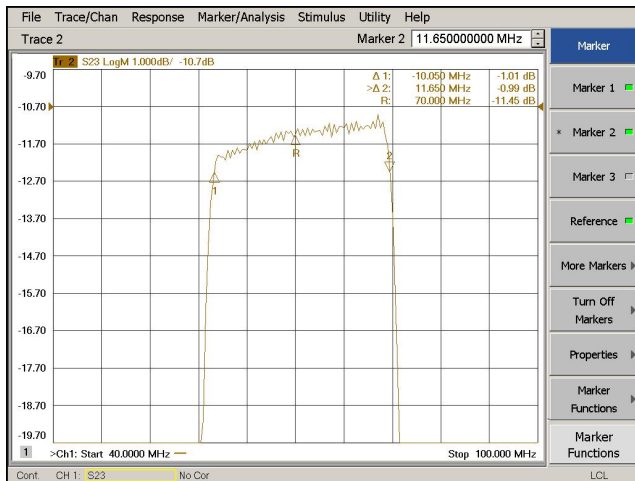
### BW-1dB 典型测试曲线@25°C



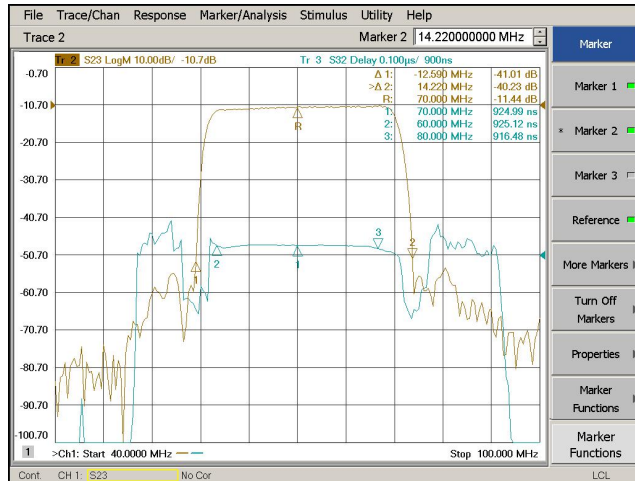
### BW-40dB 典型测试曲线@25°C



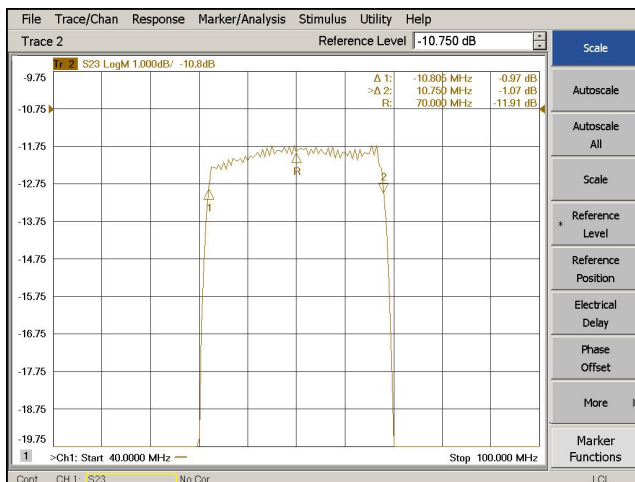
### BW-1dB 典型测试曲线@-55°C



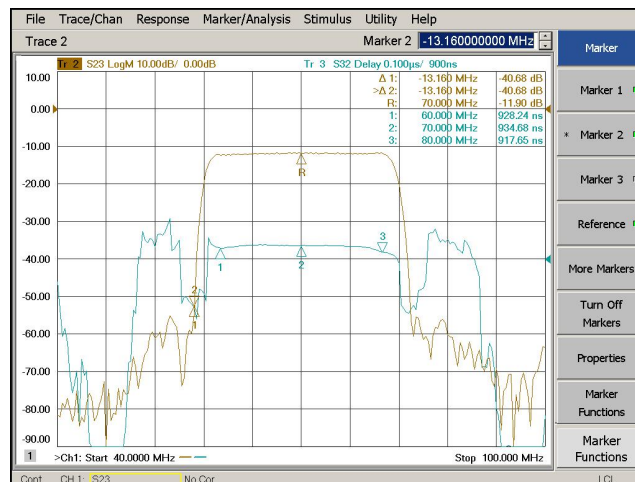
### BW-40dB 典型测试曲线@-55°C



### BW-1dB 典型测试曲线@85°C



### BW-40dB 典型测试曲线@85°C

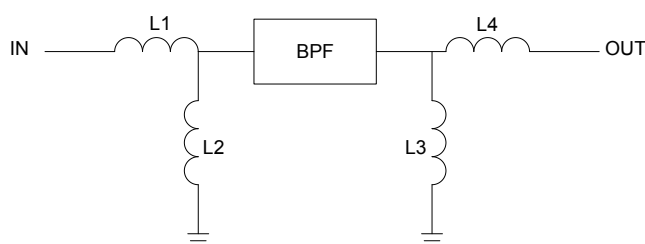


**字符标志:**

YSF70B21Q	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

**引脚定义:**

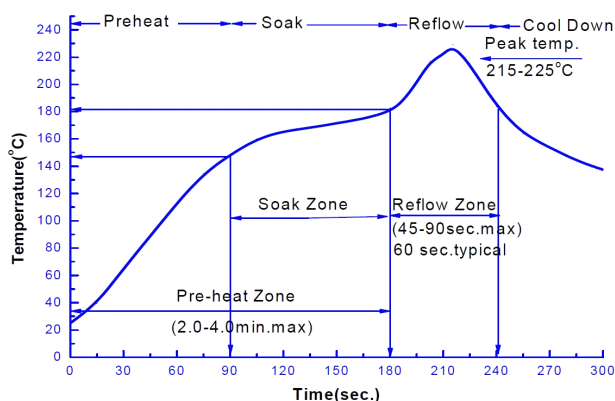
接口标识	接口说明
11	输入
5	输出
其他引脚	GND

**推荐装配电路:**

**推荐装配值:**

位号	感/容值
L1 L3	120nH,精度≤5%
L2	270nH,精度≤5%
L4	91nH,精度≤5%

**产品使用注意事项:**

1. 产品在运输、装配使用过程中请注意物理防护;
2. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用, 推荐采用 Sn63Pb37 的焊锡膏回流焊接, 回流温度推荐曲线:



此图为推荐回流温度曲线, 因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线, 实测回流基板温度不得超过 230°C。

3. 如特殊情况需采用手工焊接, 烙铁温度 350°C, 焊接时间不超过 3 秒; 回流及手工焊接次数不大于 3 次。
4. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装, 存放条件: 温度 10~35°C, 湿度 35~65%RH; 对于需长期储存 (超过半年) 产品尽量在充氮干燥环境下存放。
5. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境, 客户在对产品焊接及清洗完成后, 应对宇熙产品进行三防喷涂处理, 以提高产品耐环境适应性能力。